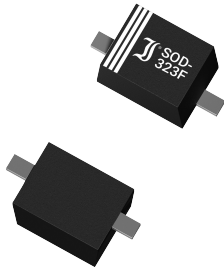


1SS5004WS	I_{FAV} = 225 mA	V_{RRM} = 400 V
High Voltage Small Signal Diodes in SMD	V_{F1} < 0.87 V	I_{FSM} = 2 A
Hochspannungs-Kleinsignaldioden in SMD	T_{jmax} = 150°C	t_{tr} < 100 ns

Version 2021-09-24

SOD-323F



SPICE Model & STEP File ¹⁾



Marking Code
YM

HS Code 85411000

Typical Applications

Signal processing,
High-speed switching
Commercial grade
Suffix -Q: AEC-Q101 compliant ¹⁾
Suffix -AQ: AEC-Q101 qualified ¹⁾

Features

High reverse voltage
Low junction capacitance
Low leakage current
Compliant to RoHS (w/o exemp.)
REACH, Conflict Minerals ¹⁾



Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled 3000 / 7"
Weight approx. 0.005 g
Case material UL 94V-0
Solder & assembly conditions 260°C/10s
MSL = 1

Typische Anwendungen

Signalverarbeitung,
Schnelles Schalten
Standardausführung ¹⁾
Suffix -Q: AEC-Q101 konform ¹⁾
Suffix -AQ: AEC-Q101 qualifiziert ¹⁾

Besonderheiten

Hohe Sperrspannung
Niedrige Sperrschichtkapazität
Niedriger Sperrstrom
Konform zu RoHS (ohne Ausn.)
REACH, Konfliktminerale ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet auf Rolle
Gewicht ca.
Gehäusematerial
Löt- und Einbaubedingungen

Maximum ratings ²⁾

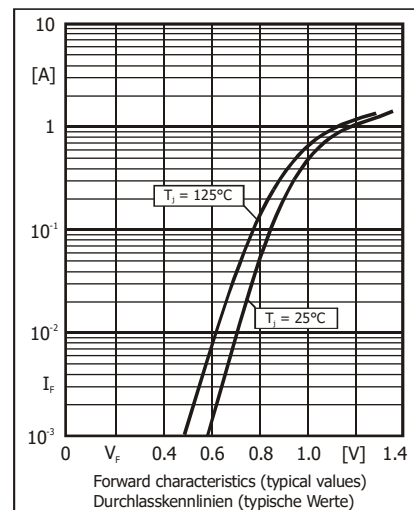
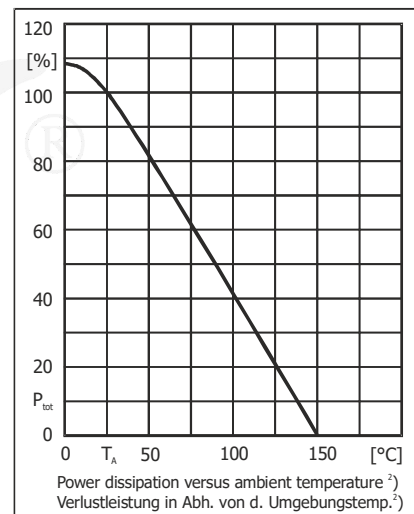
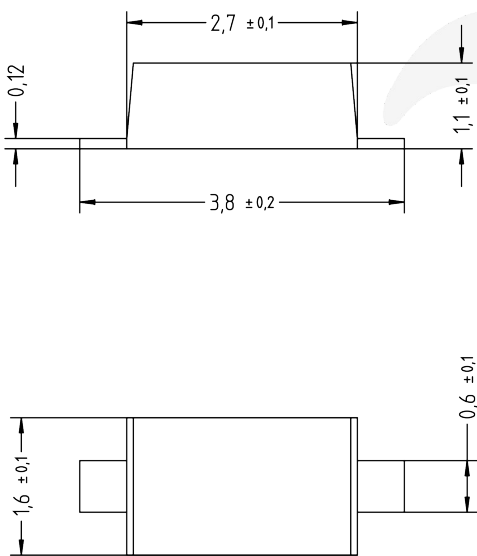
Grenzwerte ²⁾

Power dissipation Verlustleistung		P _{tot}	350 mW ³⁾
Max. average forward current Dauergrenzstrom	DC	I _{FAV}	225 mA ³⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom		I _{FRM}	625 mA ³⁾
Non repetitive peak forward surge current Stoßstrom-Grenzwert	t _p ≤ 1 ms	I _{FSM}	2 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Sperrspannung		V _{RRM}	400 V
Reverse voltage Sperrspannung	DC	V _R	240 V
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _j T _s	-55...+150°C -55...+150°C

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
2 T_A = 25°C unless otherwise specified – T_A = 25°C wenn nicht anders angegeben
3 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal – Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Lötpad je Anschluss

Characteristics
Kennwerte

Forward voltage Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 20\text{ mA}$ 100 mA 200 mA	V_F	$< 0.87\text{ V}$ $< 1.0\text{ V}$ $< 1.25\text{ V}$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = 240\text{ V}$	I_R	$< 100\text{ nA}$
Junction capacitance Sperrschichtkapazität		$V_R = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	C_T	typ. 5 pF
Reverse recovery time Sperrverzögerung		$I_F = 30\text{ mA}$ über/through $I_R = 30\text{ mA}$ bis/to $I_R = 3\text{ mA}$	t_{rr}	$< 100\text{ ns}$
Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung			R_{thA}	$< 350\text{ K/W}^1)$

Dimensions - Maße [mm]


Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Mounted on P.C. board with 3 mm^2 copper pad at each terminal – Montage auf Leiterplatte mit 3 mm^2 Lötpad je Anschluss